

概要 500字

Sn めっきや Sn-Ag-Cu 系はんだ上に発生する筒状のウイスカ状突起物は、85°C85%RH の耐湿試験で Br の偏在を伴って発生し、メタルの Sn ウイスカではなく、SnO のウイスカであることが確認された。このウイスカは、絶縁体であり、短絡のリスクはないが、Br による Sn めっき層の腐食が顕著であり、また Sn ウイスカとの誤認によるトラブルの原因にもなることから、発生状況や分析結果を示すと共に発生メカニズムを検討した。さらに、この SnO ウイスカが発生しやすくなるはんだフラックス残渣の多い状態での故障リスクも合わせて報告する。